



2025年1月17日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 池田和明
(コード番号: 6638 東証プライム)
問い合わせ先 常務取締役 清水浩司
電話番号: 0268-80-0058

当社連結子会社による半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 (SATAS) への
新規加入のお知らせ

当社の連結子会社であるアルファードesign株式会社は、この度、半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 (SATAS) に加盟しましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

以上

当社連結子会社による半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（SATAS）への 新規加入のお知らせ

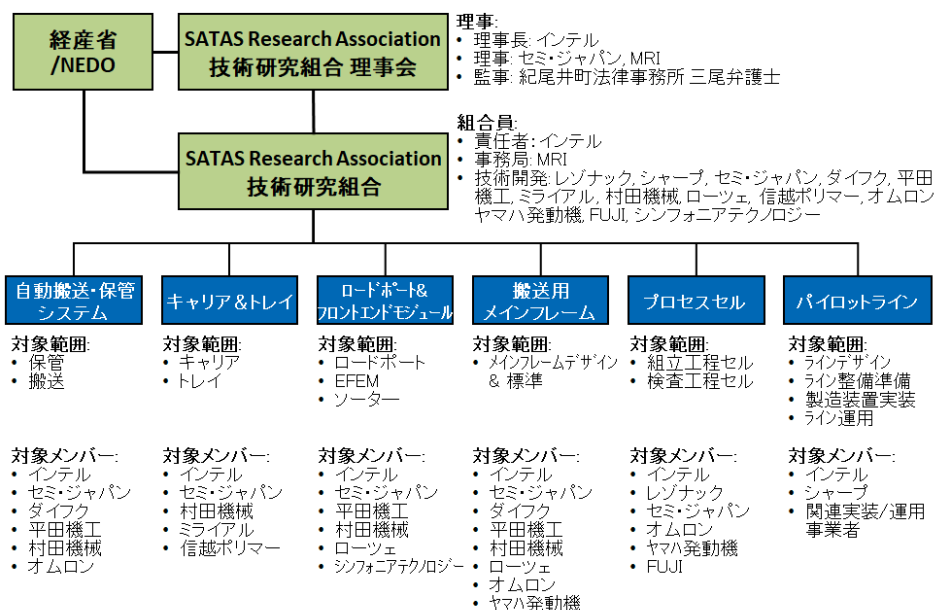
株式会社ミマキエンジニアリング（本社／長野県東御市、代表取締役社長／池田 和明）の連結子会社で半導体実装装置の開発・製造・販売を手掛けるアルファードesign株式会社（本社／長野県東御市、代表取締役社長／森澤 修二郎）は、この度、半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（以下、SATAS）に加盟しましたことをお知らせいたします。

POINT

- ・SATASは、後工程自動化に必要な技術およびオープンな業界標準仕様の作成、装置の開発と実装、統合されたパイロットラインでの装置の動作検証を行い、2028年の実用化を目指します。本事業で得られた知見や技術を既存および新規工場へ導入・実装できる基盤を確立・実証することが、実用化に向けた重要な目標となります。
- ・後工程プロセスのなかで AI チップに採用されつつあるブリッジ接続技術は、近年の半導体設計における革新技術の一つであり、次世代の高性能コンピューティングシステムを構築するために重要な役割を果たしています。当社はコア技術であるフリップチップ搭載技術により高精度搭載が求められるブリッジ接続・SoC 接続工程での業界貢献を目指しています。

SATAS 概要

半導体メーカー「インテル」が主幹となり、半導体メーカー・半導体製造装置や自動搬送装置メーカー・標準化団体などによる企業と団体に組織する組合です。半導体製造のパッケージング・アセンブリーやテスト工程（以下、後工程）のトランスフォーメーションおよび完全自動化を目的として、2024年4月16日に設立されました。設立時15企業・団体であった組合員は2024年9月時点で22企業・団体となっておりますが、この度新たに2社追加加入する企業のうちの1社として技術研究組合活動へ参画します。



(同組合 HP より抜粋)

■アルファードesignが SATAS に加入する目的・貢献領域

アルファードesignは、強みとするフリップチップ搭載技術により後工程の自動化・標準化に貢献して参ります。

■アルファードesignが SATAS 内で担う役割と具体的な活動

- ・後工程自動化に必要な技術開発
- ・搬送用メインフレーム プロセスセルワーキンググループへの参加

■半導体業界向けの当社製品

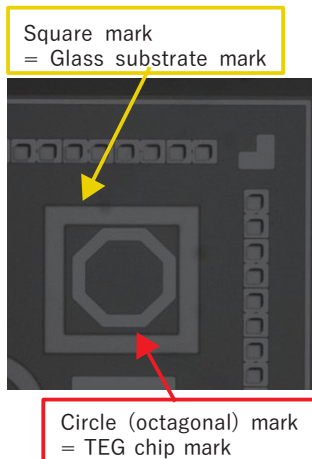
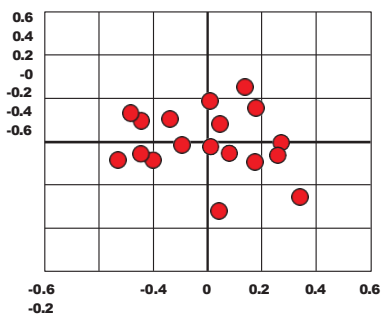
Features



HSB-300II

1. HSB-300II achieves $\pm 1\mu\text{m}$ of high accuracy bonding
2. Equipped with head-stage parallelism and mounting position calibration
3. Capable of handling various thermal process
4. Stage size is $\square 300\text{mm}$ compatible

Bond Accuracy



| | | |
|-------------------|--|--|
| Model name | High precision flip chip bonder | |
| Model | HSB-300II | |
| Target board size | 50x50mm~250x200mm t = 0.5mm~2.5mm $\phi 200\text{mm}$ or $\phi 300\text{mm}$, t= $0.4\sim 0.775\text{mm}$ OP: $\square 300\text{mm}$ | |
| Target part size | $\square 1\text{mm}$ to $\square 15\text{mm}$ t = 0.05mm to 0.5mm (0.05mm has conditions) ~ $\square 30\text{mm}$ (camera needs replacing) | |
| Dimension | Width1,350 x Depth1,855 x Height1,680mm | |
| Weight | Approximately 1,600 kg | |
| Power source | Power supply | 3-phase AC200V-30A (50/60Hz), single-phase AC100V-30A (50/60Hz) |
| | Dry air | 0.5MPa |
| | Vacuum | -80kPa |
| Parts supply form | Wafer supply 8 inch, 12 inch tray supply 2 inch 4 inch | |
| Mounting accuracy | $\pm 1\mu\text{m}^*$ | |
| Cycle time | 1.6sec/chip * Process time is excluded. | |
| Pressurized range | 5N-150N *0.5N to 5N settings are possible (reference values) | |
| Heating range | Head: Normal temperature-Max. 450°C Stage: Normal temperature-Max. 200°C | |
| Option | Non-heating head, TCB head, and US head are replaceable. | |
| | Equipped with head-stage parallelism and mounting position calibration. | |

株式会社ミマキエンジニアリングについて

ミマキエンジニアリングは、産業用インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ、3Dプリンタおよびそのインク、ソフトウェアの開発・製造・販売・保守を行っています。サイングラフィックス、インダストリアルプロダクツ、テキスタイルアパレルの市場に向け、プリント工程のトータルソリューションを提供することにより、お客様に常に「新しさと違い」をお届けするイノベーターを目指しています。

企業・IR サイト： <https://ir.mimaki.com/>

製品サイト： <https://japan.mimaki.com/>

アルファードesign株式会社について

アルファードesignはファクトリーオートメーション装置や半導体実装装置、基板実装装置の開発・製造・販売を行っています。基板実装工程・基板検査工程で活躍する製品を始め、半導体実装装置、電子部品挿入機、プレスフィットコネクタ圧入装置、フリップチップボンダなど、世界有数の性能を持つ高精度装置を研究・開発・販売しています。長野県東御市に本社を置くほか国内5カ所、中国に3カ所の営業拠点を展開。1989年に創業し、2018年より株式会社ミマキエンジニアリングのグループ会社となっています。

<https://www.alpha-design.co.jp/>

お問い合わせ先

アルファードesign株式会社
長野県東御市滋野甲 2211-3
TEL：0268-64-0088
FAX：0268-64-0080

株式会社ミマキエンジニアリング
コーポレート統括本部 I R 部
長野県東御市滋野乙 2182-3
TEL：0268-80-0058 / FAX：0268-64-2285
MAIL: mimaki-ir@mimaki.com